(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2007 年2 月15 日 (15.02.2007)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/018041 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/683 (2006.01) *H01L 21/52* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2006/314852

(22) 国際出願日: 2006 年7 月27 日 (27.07.2006)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2005-232943 2005 年8 月11 日 (11.08.2005) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): リンテック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 野中英明 (NONAKA, Hideaki) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 小林賢治 (KOBAYASHI, Kenji) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 山口義雄 (YAMAGUCHI, Yoshio); 〒2060034 東京都多摩市鶴牧１丁目４番１７号 いずみビル８Ｆ Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

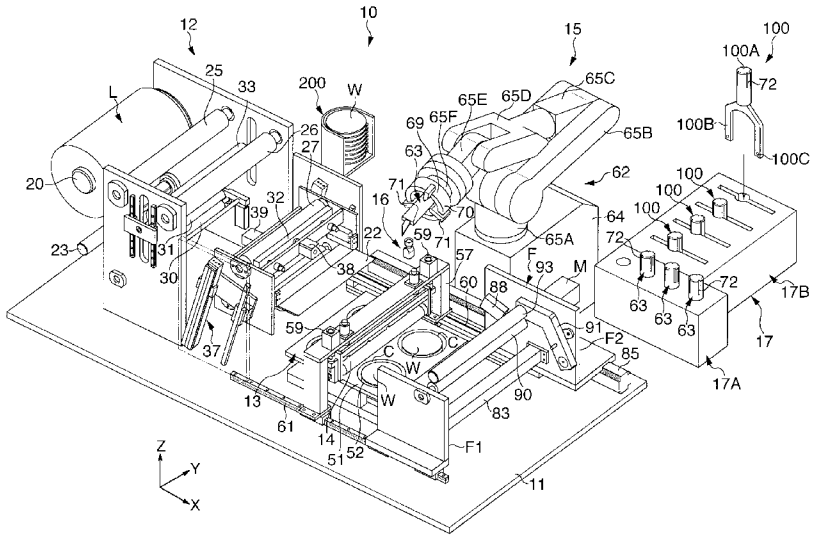
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

[続葉有]

(54) **Title:** SHEET APPLICATION DEVICE AND APPLICATION METHOD

(54) 発明の名称: シート貼付装置及び貼付方法



(57) **Abstract:** A wafer (W) is supported on each inner table (52) of a table (13). After a band-like sheet (S) is paid out on to the upper surface side of the wafers (W), pressing force is applied to the sheet by a pressing roller (14). The adhesion sheet (S) is cut along wafer outer edges by a cutter blade (63) installed on the free end side of a robot (15). The robot (15) has a function of passing the cutter blade (63) to a suction arm (100) and conveying wafers (W) from a magazine (200) to the table (13) and a function of transferring wafers (W), to which the sheet has been applied, to a post process.

[続葉有]

WO 2007/018041 A1

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

テーブル（１３）の各内側テーブル（５２）にウエハ（W）がそれぞれ支持され、これらウエハ（W）の上面側に帯状のシート（S）を繰り出した後に、押圧ローラ（１４）が押圧力を付与する。接着シート（S）は、ロボット（１５）の自由端側に装着されたカッター刃（６３）によってウエハ外縁に沿って切断される。このロボット（１５）は、カッター刃（６３）を吸着アーム（１００）に持ち替え動作してマガジン（２００）からテーブル（１３）にウエハ（W）を搬送し、またシート貼付済みのウエハ（W）を後工程へ移載する機能を備えている。